04;05;10;11

Изменение стехиометрии и ускорение диффузии Ті в $Al_2O_3/Al/C$ в результате воздействия электронного пучка

© А.Д. Погребняк, Б.П. Гриценко, С.М. Дуванов, Н.А. Погребняк, М.К. Кылышканов, В.В. Понарядов

Сумский институт модификации поверхности, Сумы, Украина Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия Отдел пучковой модификации поверхности Института металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины

Восточно-Казахстанский технический университет, Усть-Каменогорск, Казахстан

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь E-mail: apogrebnjak@simp.sumy.ua

Поступило в Редакцию 24 апреля 2006 г.

Впервые с помощью обратного рассеяния ионов (BS) $\mathrm{He^{+4}}$ и сканирующей электронной микроскопии (SEM) с микроанализом (WDS) были исследованы изменения в стехиометрии комбинированного покрытия из $\mathrm{Al_2O_3/Al/C}$ и проведен расчет коэффициента диффузии Ті в результате воздействия электронным пучком. Обнаружено увеличение "эффективного" коэффициента диффузии и изменения соотношения концентрации Al и O в слое α - $\mathrm{Al_2O_3}$, в котором также произошло замещение кислорода на углерод.

PACS: 81.15.Hi, 81.05.Hd

В технике широко применяются изделия, изготовленные из углеродных композитов [1–3]. Но во время их эксплуатации в кислородосодержащей среде при высоких температурах углерод окисляется. Как известно, метод электродуговой металлизации имеет высокую производительность и относится к наиболее производительным и низкозатратным технологиям получения покрытия. Эта технология осуществляется путем плавления дугой и распыления газом материала проволоки [2,4]. Использование для металлизации поверхности изделия проволоки из Al обеспечивает формирование покрытия с высокой пластичностью и низкой пористостью. Защита поверхности

алюмизированного изделия осуществляется теплостойким слоем из окиси алюминия, который создается технологией на основе плазменно-электролитного оксидирования в электролитах на водной основе [1-3]. Эти технологии отличаются низкими затратами материалов и энергии, а также обладают простым оборудованием. Они позволяют часть слоя из алюминия окислить и сформировать в виде высокотемпературного окисла алюминия — α -Al₂O₃.

Кроме того, в ряде работ было показано, что имплантация ионов Ті в ${\rm Al_2O_3}$ (полученный различными методами [5–9]), приводит к улучшению механических характеристик, таких как стойкость к износу, стойкость к коррозии. Был также обнаружен двухстадийный процесс диффузии Ті при термическом отжиге [5,6,8]. Поэтому целью данной работы было исследование влияния имплантации ионов Ті и последующего облучения электронами на процессы диффузии и механические свойства.

На изделие из графитного материала проводилось металлирование алюминием, а затем проводилось дальнейшее плазменно-электролитное оксидирование. Эти процессы хорошо описаны в работах [3]. Из изделия были вырезаны образцы размером $25 \times 5 \times 5$ mm. Со стороны оксидированного слоя толщиной около $120\,\mu\text{m}$ на поверхность проводилась имплантация ионов Ті дозой $3 \cdot 10^{17}~(60~\text{kV})$ и $2 \cdot 10^{17}~\text{cm}^{-2}~(90~\text{kV})$ на ускорителе "Диана" в вакууме $\approx 5 \cdot 10^{-3}~\text{Pa}$. Затем на одной части образцов (со стороны Al_2O_3) проводилась обработка поверхностного слоя электронным пучком 30~kV в двух режимах: полного и частичного плавления Al_2O_3 на установке "У-112" Института электросварки НАН Украины.

Измерения энергетических спектров обратного рассеяния (OP) ионов ${\rm He^+}$ с $E_0=1.5\,{\rm MeV}$ проводили на ускорителе [5,7]. Обратнорассеянные ионы регистрировались под углом $\theta\approx 170^\circ$. Полупроводниковый детектор имел разрешение $18\,{\rm keV}$, анализ проводился в вакууме $1\cdot 10^{-4}\,{\rm Pa}$. Исследования морфологии и элементного анализа проводили с помощью растровой электронной микроскопии (SEM) с микроанализом (WDS) на установке PЭMA-102M (Selmi; Electron, Sumy). Измерения нанотвердости образцов (в неоплавленной части) проводили с помощью Nano Indentor II, MTS System Corporation Oak Ridge, TN (USA).

На рис. 1,a представлено изображение поверхности образца с покрытием из $Al_2O_3/Al/C$ после имплантации и последующего плавления

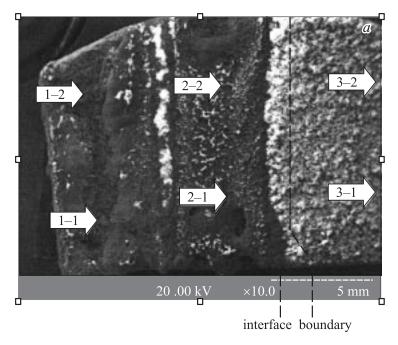
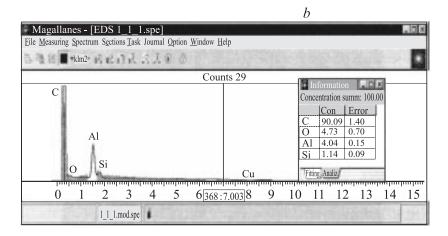


Рис. 1. a — изображение поверхности комбинированного покрытия $Al_2O_3/Al/C$ после имплантации ионов Ti с E=60 и $90\,\mathrm{kV}$ суммарной дозой $5\cdot 10^{17}$ (участок 3-2 и 3-1); облученного электронным пучком с плотностью мощности $2\cdot 10^3\,\mathrm{W/cm^2}$ (участок 1-2; 1-1); облученного электронным пучком с плотностью мощности $1\cdot 10^3\,\mathrm{W/cm^2}$ (участок 2-1; 2-2). b, c, d — спектры элементного анализа, полученные в локальных точках, обозначенных на рис. 1,a, с помощью WDS.

электронным пучком. На изображении можно выделить три области: в области I полностью расплавлен слой оксида алюминия и почти испарился слой Al; область 2 — также обработана электронным пучком с плотностью энергии в 2 раза меньшей, чем в области I (на поверхности имеются мелкие зерна и "капли" из Al и Al $_2$ O $_3$); область 3 не подвергалась воздействию электронного пучка (однако на границе этой области произошел отжиг в результате переноса тепла толщиной около $0.5 \div 1$ mm).

41



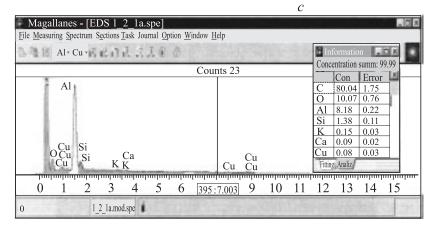


Рис. 1 (продолжение).

На рис. 1, a обозначены точками участки поверхности, на которых проводился микроанализ. Как видно из этих точек (рис. 1, a, c, d) в I-й области около 90%С и около 4.73% O_2 и 4.04% Al, т.е. в результате облучения стехиометрия Al_2O_3 значительно меняется (уменьшается концентрация кислорода). На второй области, если следовать резуль-

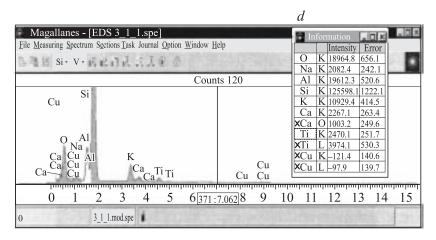
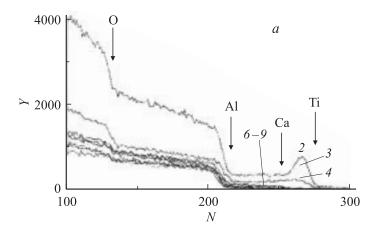


Рис. 1 (продолжение).

татам микроанализа, 80%C, $Al \approx 8.18\%$, около 10% O₂, немного Si и Ca. На третьей области имеется около 10% Ti, свыше 80% Al_2O_3 ; как неконтролируемая примесь небольшая концентрация 1.6% Si, Ca и K, которые присутствуют в оксиде алюминия в процессе плазменного электролитного оксидирования.

На рис. 2, a представлены энергетические спектры, снятые для образцов с покрытием из $Al_2O_3/Al/C$ после имплантации ионов Ті (двумя дозами) в разных точках образца до и после обработки электронным пучком. Как видно из рисунка, максимальная концентрация Ті составляет около 10 at.% и затем уменьшается, что хорошо видно из спектра. Выявлено также, что наряду с Al_2O_3 в покрытии присутствуют примеси Ca до 1.5% и немного, 0.1 at.%, Co.

Из-за высокой шероховатости поверхности покрытия очень трудно точно получить из спектров концентрации ионов Ті. Однако, используя обработку [6], мы получили профили Ті для трех разных участков образцов (рис. 2,b). Как видно из рисунка, пиковая концентрация Ті уменьшается, однако часть титана диффундирует в глубь покрытия (с увеличением температуры) и профиль сдвигается на глубину свыше $300\,\mathrm{nm}$. Обработка профилей ионов проводилась с учетом пробега двухзарядных состояний ионов Ті, а также того, что концентрация двух-



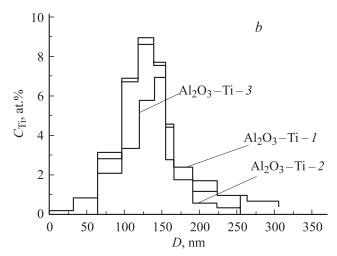


Рис. 2. a — энергетические спектры обратного рассеяния, измеренные на комбинированном покрытии в тех точках, которые обозначены на рис. 1,a (N — номер клапана). b — концентрационные профили имплантированных ионов Ti в покрытии, полученные из энергетических спектров (рис. 2,a) для трех разных точек: после имплантации, после облучения электронным пучком с меньшей и большей плотностью мощности.

зарядных ионов составляет 82% [7], что соответствует энергии ионов около $180\,\mathrm{keV}$. Облучение электронным пучком покрытия из $\mathrm{Al_2O_3}$ в режиме плавления приводит к частичному испарению поверхностного слоя и движению ионов Ті ближе к поверхности. Концентрация Ті резко уменьшается от 10 до 1.2 at.%.

Оценки "эффективного" коэффициента диффузии показывают, что он сильно меняется от условий обработки электронным пучком. При воздействии СЭП (без оплавления) оценочная температура 1400° С в середине переходной области, коэффициент $D_1=6.5\cdot 10^{-8}~{\rm cm}^2/{\rm s}$, при оплавлении режим 1; $D_2=3.7\cdot 10^{-5}~{\rm cm}^2/{\rm s}$, а при полном плавлении и частичном испарении $D_3=10^{-4}~{\rm cm}^2/{\rm s}$. Расчет эффективного коэффициента диффузии проводился с помощью уравнения Фика второго ряда без учета того, что в результате плавления трехслойного покрытия температура плавления отдельных слоев сильно различается.

Можно предположить, что диффузия Ті проходит три стадии: движение по вакансионному механизму в глубь покрытия (первая стадия), вторая стадия — усиление диффузии в глубь покрытия и третья — смена направления движения диффузии (движение Ті из глубины к поверхности за счет конвективного движения).

Описывается профиль с помощью функции Гаусса. Во втором случае, когда покрытие из Al_2O_3 с имплантированным Ті обрабатывалось в режиме частичного плавления, профиль обрабатывался двумя Гауссианами, один из которых, более широкий Гауссиан — изотропное распределение Ті в слое оксида алюминия. Первый (узкий) Гауссиан связан с образованием мелкодисперсных преципитатов, в состав которых входит Ті, по-видимому, TiAl.

Из энергетических спектров OP видно, что в результате плавления трехлойной системы (комбинированного покрытия) происходит замещение атомов кислорода на атомы углерода (см. рис. 2, a).

Анализ кривых нагружения и разгрузки (при использовании наноиндентора) показал, что нанотвердость покрытия из $Al_2O_3/AL/C$ после имплантации ионов Ті возросла с $13.8\pm0.9\,\mathrm{GPa}$ до $17.6\pm1.2\,\mathrm{GPa}$ (в отдельных участках покрытия). Отжиг участка в переходной области покрытия (расчетная температура $1400\div1500^\circ\mathrm{C}$) приводит к небольшому увеличению нанотвердости до $18.4\pm0.35\,\mathrm{GPa}$ и меньшему разбросу значений. В оплавленной области нанотвердость очень резко уменьшается (почти в 2 раза) по сравнению с имплантированной поверхностью покрытия.

В заключение можно сказать, что диффузия Ті в оксиде алюминия проходит три стадии в результате облучения сильноточным электронным пучком (по-видимому, связана с различными механизмами массопереноса). Стехиометрия покрытия, нанесенного плазменно-электролитным осаждением в результате воздействия СЭП, изменяется в виде соотношения концентрации кислорода и алюминия, при этом происходит частичное замещение кислорода на углерод.

Работа была финансирована по проекту "Наносистемы, нанотехнологии и наноматериалы (новые физические принципы получения наноматериалов, нанопленок, нанопокрытий с помощью ионных, плазменных и электронных пучков)" НАН Украины.

Авторы благодарны Ф.Ф. Комарову (Минск, Беларусь) за помощь в измерении спектров BS.

Список литературы

- [1] Погребняк А.Д., Тюрин Ю.Н. // ЖТФ. 2004. Т. 74. В. 8. С. 109–112.
- [2] Черненко В.И., Снежко Л.А., Папанова И.И. Получение покрытий анодноискровым электролизом. Л.: Химия, 1991. 128 с.
- [3] *Черненко В.И., Снежко Л.А., Папанова И.И., Литовченко К.И.* Теория и технология анодных процессов при высоких напряжениях. Киев: Наук. думка, 1995. 97 с.
- [4] Марков Г.А., Симонова А.И., Гириевич О.П. // Защита металлов. 1997. № 3. С. 289–294.
- [5] Duvanov S.M., Balogh A.G. Nucl. Instr. and Meth. NIMB. 2000. B 171. P. 475.
- [6] Pells G.P. // J. Amer. Ceram. Soc. 1994. V. 77 (3). P. 368.
- [7] *Кадыржанов К.К., Комаров Ф.Ф., Погребняк А.Д.* и др. Ионно-лучевая и ионно-плазменная модификация металлов. М.: МГУ, 2005. 640 с.
- [8] MeHargue C.J., Sklad P.S., White C.W. // Nucl. Instrum. and Meth. 1990. B. 46. P. 79 (Review).
- [9] Pogrebnjak A.D., Kravchenko Yu.A., Kislitsyn S.B. // Surf. and Coat. Tech. 2006. V. 76. P. 214–225.
- [10] *Pogrebnjak A.D., Gritsenko B.P., Pogrebnjak N.A.* et al. // 8th Intern. Conference Solid State Physics. August 23–26, Almaty. 2004. V. I. P. 105–118.
- [11] Mayer M. SIMNRA Users Guide Technical Report IPP 9/113. Max-Planck-Institute für Plasma physik. Garching, Germany, 1997.